

INPAQ TECHNOLOGY CO., LTD. **(6284)**

Investor Conference

Dec. 29th , 2025



免責聲明

- 一. 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 二. 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 三. 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

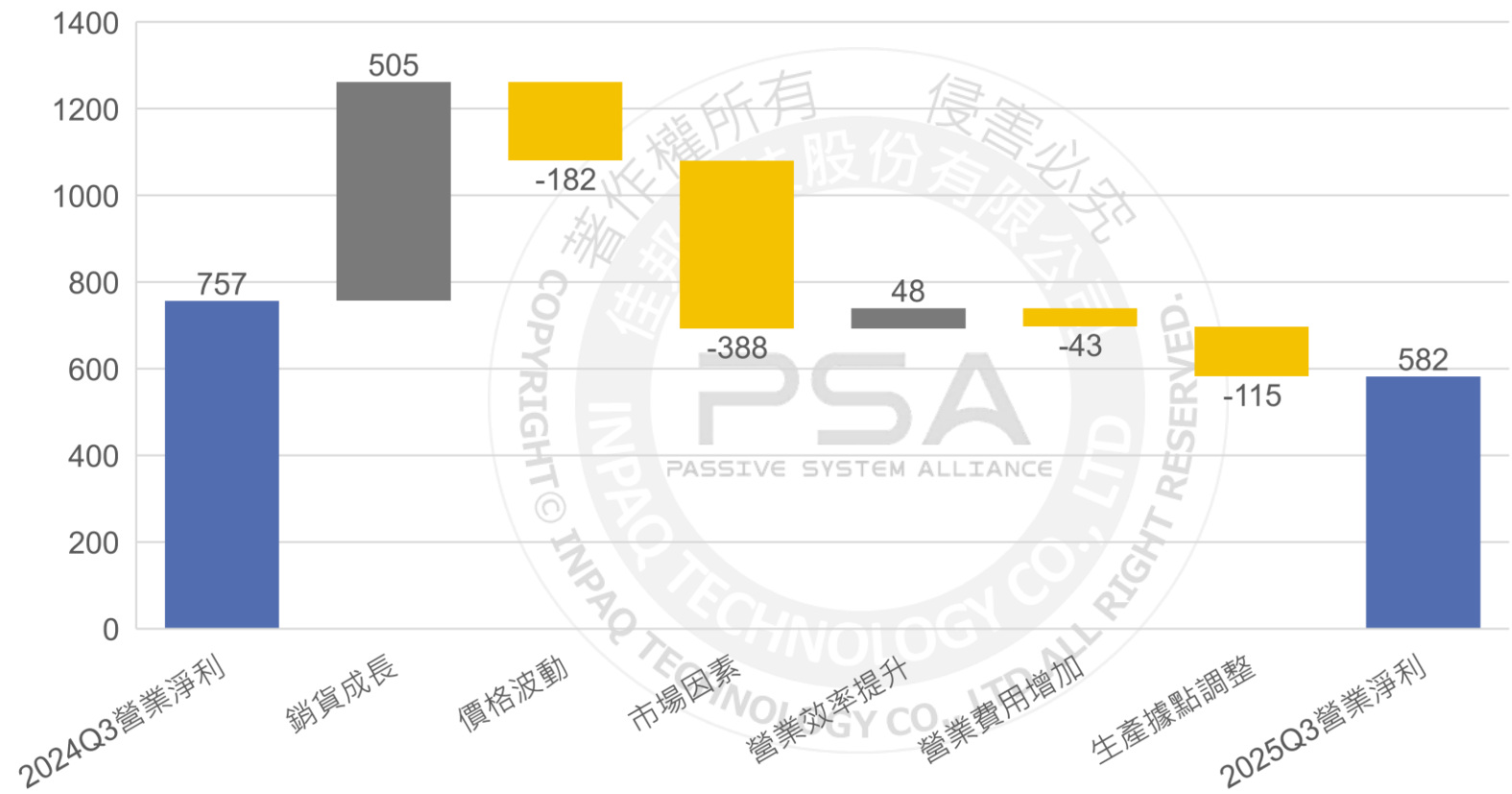
財務表現

Unit : NT\$mn, except EPS

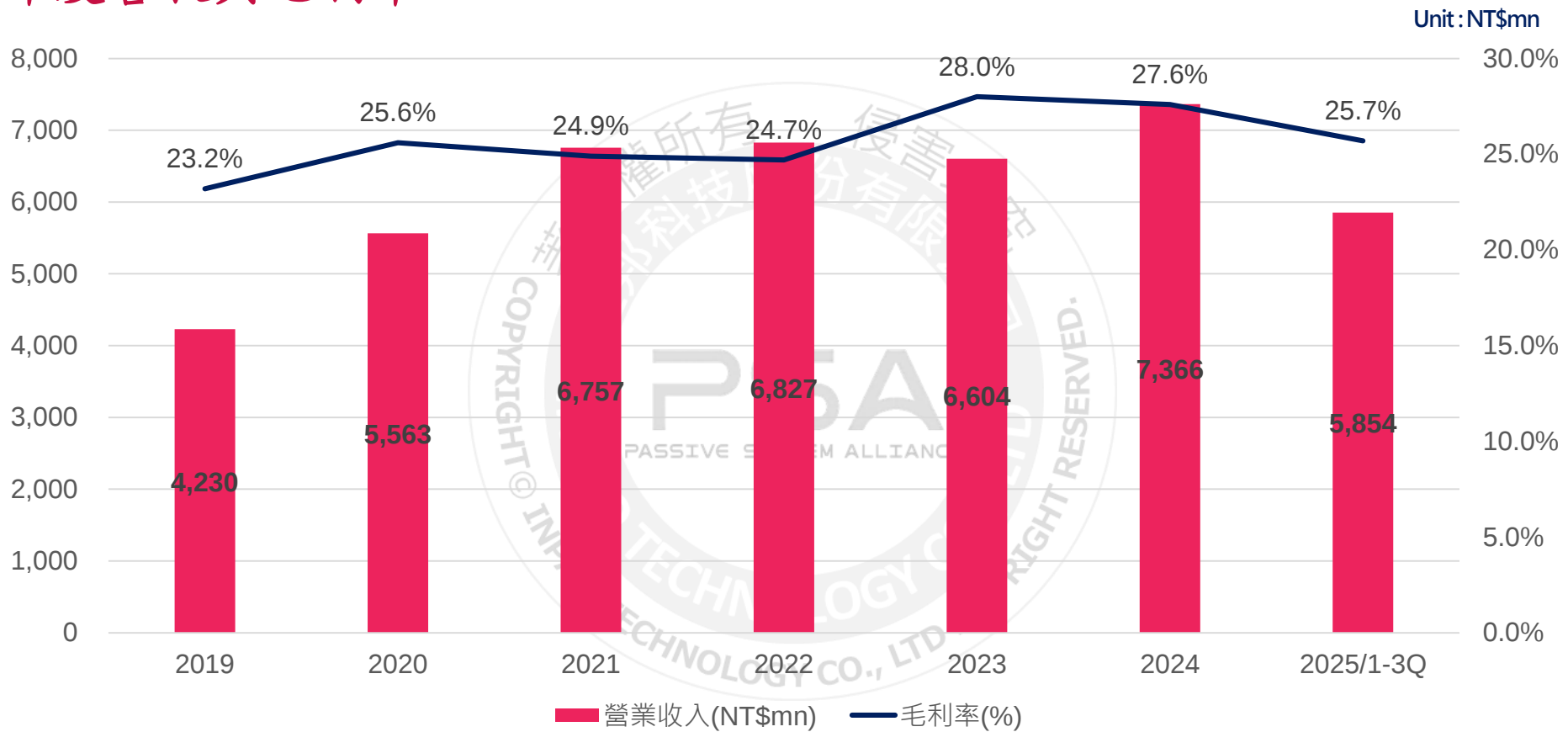
合併財務資訊	FY2025 Q1~Q3	FY2024 Q1~Q3	YoY(%)
營業收入	5,854	5,532	6%
營業毛利	1,503	1,545	-3%
營業淨利	582	757	-23%
稅前淨利(損)	574	931	-38%
稅後淨利(損)	457	695	-34%
每股盈餘(NTD)	3.12	4.70	-34%
營業毛利率(%)	25.68%	27.93%	-2.25ppt
營業淨利率(%)	9.95%	13.68%	-3.73ppt

營業淨利變動原因分析

Unit : NT\$mn



年度營收與毛利率



股息支付率

Fiscal Year	EPS(NTD)	Payout Ratio(%)
2025Q3	3.12	NOTE
2024	6.61	40.8
2023	5.01	39.9
2022	4.22	40.3
2021	4.04	29.7
2020	2.59	38.6
2019	1.34	37.3

NOTE：2025年度盈餘分配率待董事會決議

股利支付率多維持在40%，僅2021年廠房建設及自動化機械購置方面有大量資本支出，股息支付率較低，

2025Q3 財報回顧

①

②

合併財務資訊 NT\$mnn	2025 Q3	2025 Q2	QoQ(%)	2024 Q3	YoY(%)
營業收入	1,981	2,010	-1%	1,980	0%
營業毛利	488	500	-2%	542	-10%
營業淨利	185	161	15%	279	-34%
稅前淨利(損)	310	(42)	838%	202	53%
稅後淨利(損)	251	(51)	592%	170	48%
每股盈餘(NTD)	1.72	-0.34	606%	1.15	50%
營業毛利率(%)	25%	25%	0ppt	27%	-2ppt
營業淨利率(%)	10%	8%	2ppt	13%	-3ppt
稅後淨利(損)率(%)	13%	-2%	15ppt	8%	5ppt

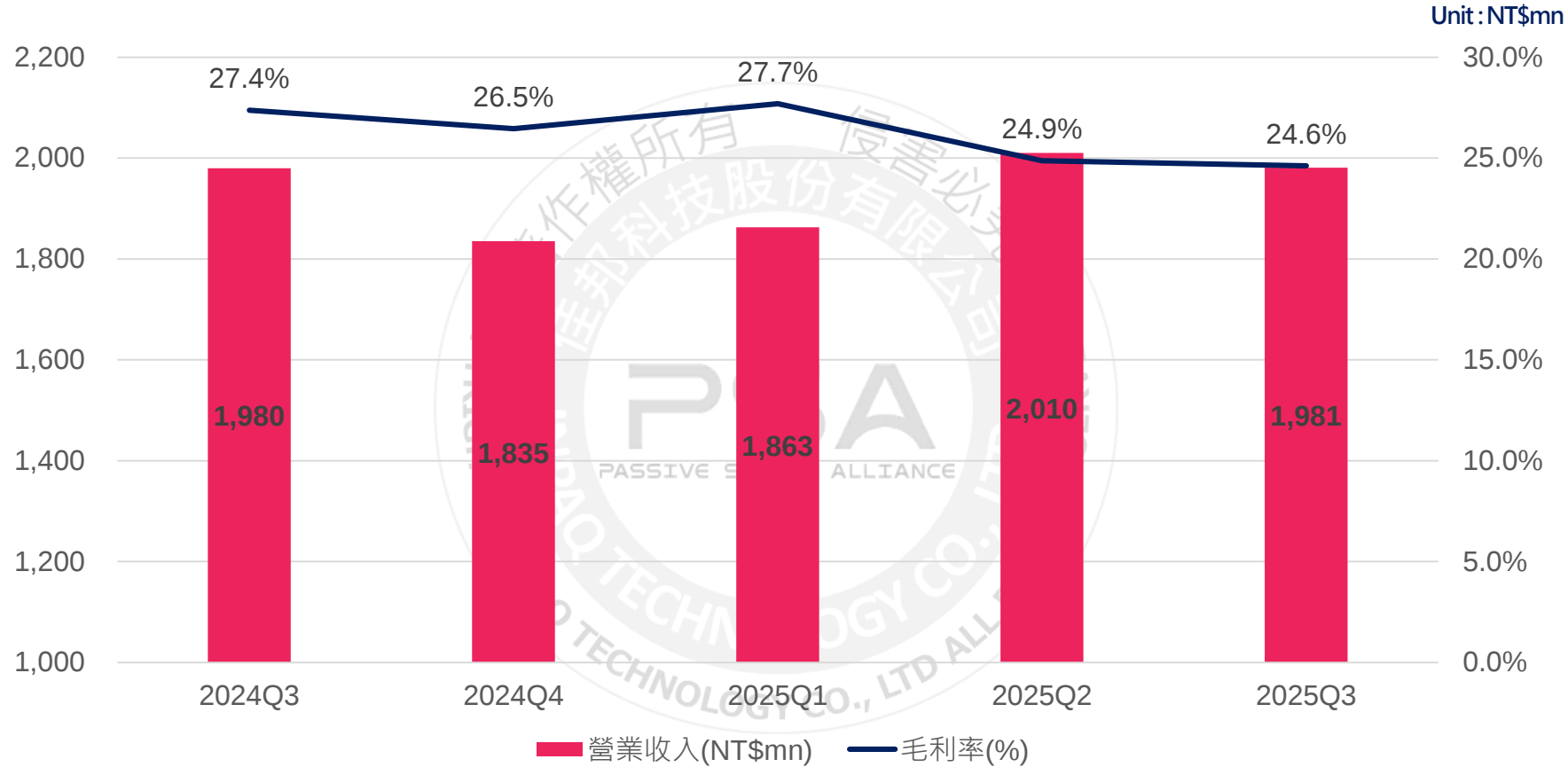
QoQ

1. Q2受美國關稅議題影響，客戶於4、5月緊急拉貨，以致25Q2營收較以往年度成長
2. 天線受到印度及北美市場需求減緩及客戶庫存堆積，導致Q3營收下降
3. 元件受中國市場價格戰加劇，整體ASP下降
4. 美元匯率走勢回穩，匯率兌換利益成長

YoY

1. 2025受國際金屬價格成長影響，銀漿、錫膏等原料價格成長，以致生產成本上升
2. 元件受中國市場價格戰影響。整體ASP較24年度下跌
3. 24Q3末台幣升值影響，匯兌損失增加

2025Q3 財報回顧

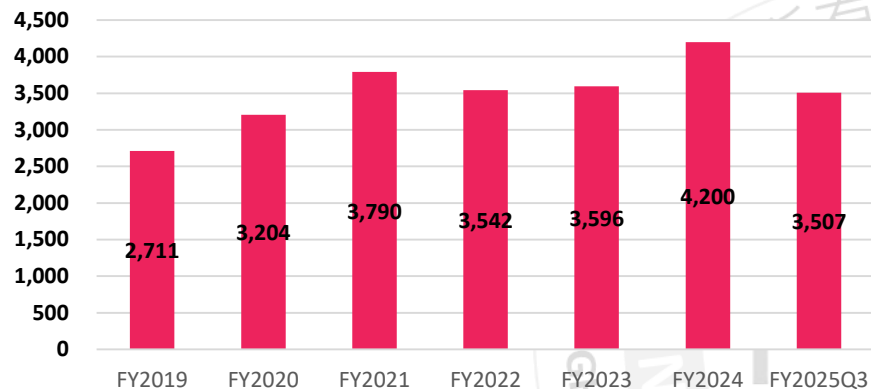


2025年營運報告



各業務部門之營收

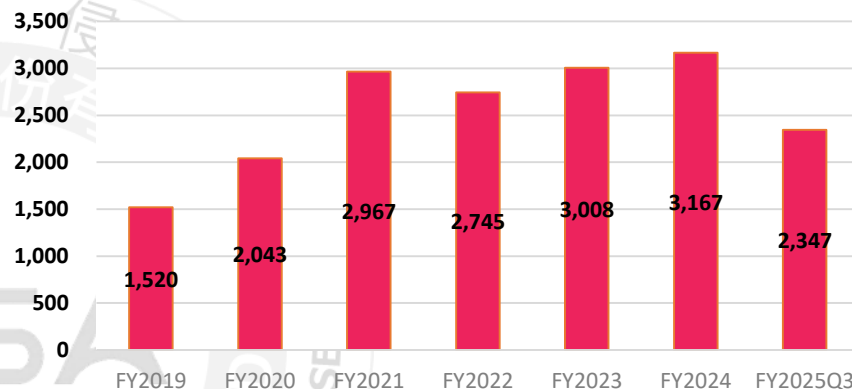
天線營收



■ 天線 營收(NT\$mn)

1. 2021年受惠於 5G 智慧型手機滲透率提升、穿戴式裝置、以及車用電子天線需求增加。
2. 2024年受北美網通市場興起、印度基礎建設所需及wifi7亮相。
3. 2025年受Win10停止支援與AI PC推動，NB需求穩健成長。

元件營收

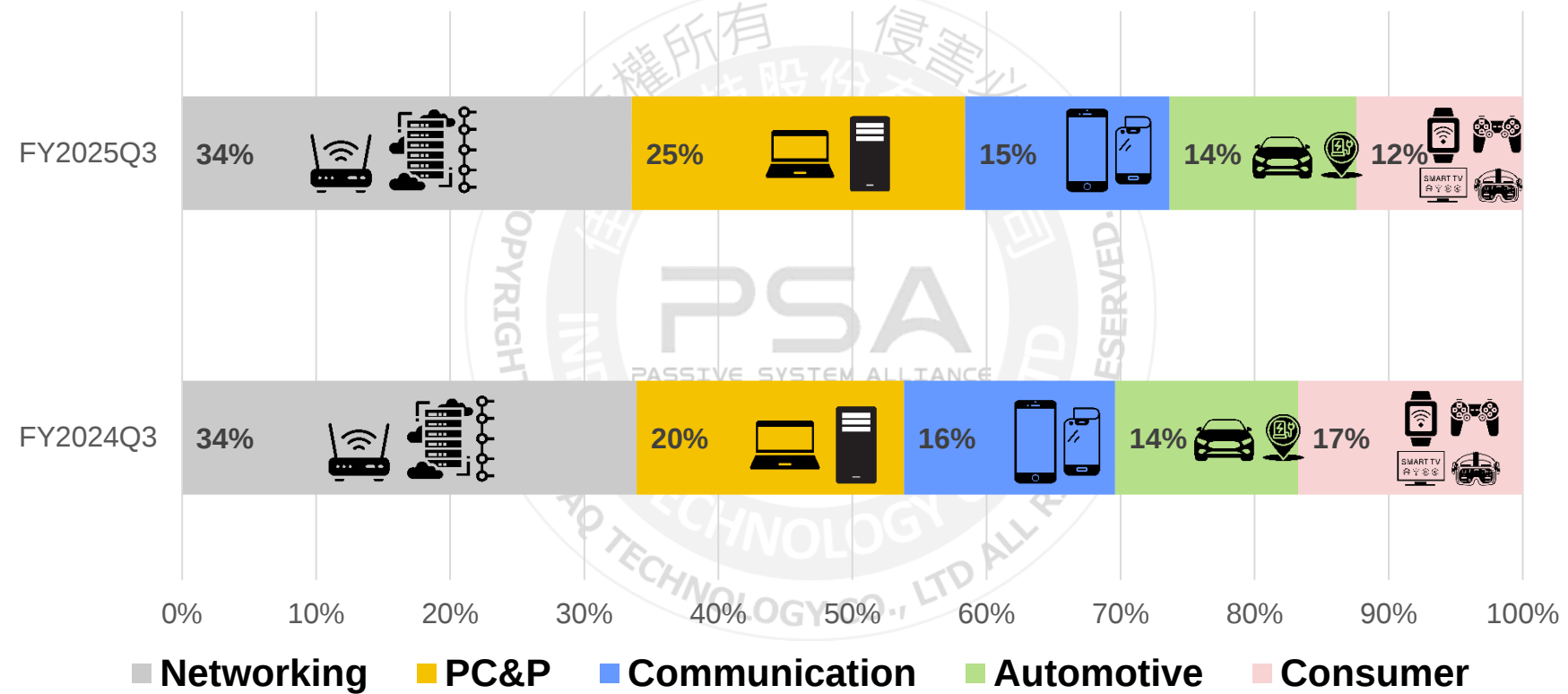


■ 元件 營收(NT\$mn)

1. 2021年增加繞線電感產品。
2. 2022年竹南二廠落成，一體成形功率電感擴產。
3. 2022年電感打入T1電動車供應鏈。
4. 2023年高頻電感導入客戶。
5. 2024年微型一體成形電感打入DDR5 for AI server。
6. 2025年一體成形電感打入低軌衛星產業。

依應用類別區分的營收

-  AP Router | Internet of things (IOT)
-  PC/NB | PAD
-  Automotive | Electric Vehicle(EV) | TCU
-  Mobile
-  Wearable | Gaming | Smart Home
- 



全球佈局

Plant X5 Sales X6 Lab X24



China

Location	Type
Suzhou	Plant Lab
Wuxi	Plant
Shenzhen	Lab Sales
Xi'an	Lab Sales
Shanghai	Sales

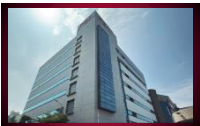


Malaysia

Location	Type
Malaysia	Plant

Global Network

Location	Type
USA	Sales Dist
Japan	Lab Dist
Korea	Dist
EU	Dist
AUS	Dist



Taiwan

Location	Type
Miaoli HQ	Plant Lab Sales
Taichung	Plant
Taipei	Lab Sales

2026年營運計畫



產業近況

1. 手機市場電感用量提高 (5G 中低階*15→23pcs)
2. PC/NB仍為大宗市場，穩定成長
3. 網通產業 WiFi 7 (電感用量增加40%)，2026 滲透率>50%
4. 存儲產品、DDR5 滲透率加速提升>40%
5. 安防監控需求增、致IOT、AI、Robot等週邊應用增加
6. 車用市場地域發展差異大。大陸電動車市場逐步好轉、日本車廠緩步回溫
7. 歐洲工控及基建市場初見曙光
8. 低軌衛星技術突破及成本下降，全力推新6G 全球通訊，帶動高頻元件及天線更多的商機

Innovation

Material Technology

- Dielectric Ceramic
- Magnetic Ceramic
- Magnetic Alloy



Competition

Process Technology

- Multilayer
- Thick film
- Thin film
- LTCC
- Molding
- Wire-wound
- LDS
- LAP

Advanced Design Service

Analysis & Evaluation

- Ansys-Maxwell, HFSS, Designer
- CST, ADS, AWR
- 24 Anechoic Chambers

01

產品力

以研發打造技術護城河

強化研發動能，建構長期競爭優勢

- 聚焦小型化、低功耗、高頻化、模組化等關鍵技術，提升產品差異化
- 深化材料與製程掌握度，整合設計、模擬與測試能力

02

市場力

擴大布局，驅動成長動能

深化行銷布局，擴展關鍵市場

- 建立全球行銷布局與管理機制，提升市場滲透率與營運彈性
- 聚焦 **Smart Connection & Position** 應用領域

03

營運力

強化體質，支撐規模化成長

優化營運體質，精進組織效能

- 持續推動 **IA 自動化生產** 與全員品質管理
- 整合生產基地資源與調度能力，建立彈性產能配置與擴充

Inpaq Matrix - UAV

FIND OUT WHAT
INPAQ
COULD PROVIDE
FOR YOUR
UAV



Lightweight GNSS Active Antenna

- Multi-constellation L1+L2 or L1+L5
- Dimension $\varnothing 36.5 \times H58$ mm
- Light weight of 21g
- LNA gain 28dB

GNSS Multi-Band Receiving Module

- GNSS band L1 or L1+L5
- Standard or high precision
- Integrated LNA & SAW filter
- RTK/DR solution available

UWB Anchor/Tag Module

- Support UWB channels 5 & 9
- Centimeter-level positioning accuracy
- Low power consumption

INPAQ Customization

**Cellular**

**NFC**

**GPS**

**WPC**

**WiFi**

PSA 佳邦科技股份有限公司
JINPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

FIND OUT WHAT
INPAQ
COULD PROVIDE
FOR YOUR
UAV



Main Board

- Mini Molding Power Inductor
- Metal Molding Power Inductor
- TVS Diode (Single, Array)
- ESD Suppressor
- Multilayer Varistor

PMIC

- Mini Molding Power Inductor
- Metal Molding Power Inductor
- Power TVS Diode
- Multilayer Varistor
- Common Mode Choke
- Power Transformer

Camera

- Multilayer Varistor
- TVS Diode (Single, Array)
- Chip Bead
- Chip RF Inductor

Remote Controller

- Multilayer Varistor
- TVS Diode (Single, Array)
- Chip Bead
- Chip RF Inductor

PSA 佳邦科技股份有限公司
JINPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Inpaq Matrix - AMR

INPAQ Empowering AMR Connectivity



5-IN-1 Combo Diamond Antenna



- 5-IN-1 combo antenna (5G MIMO*2, WIFI MIMO*2, high-precision GNSS)
- High reliability for outdoor usage

UWB Anchor/Tag Module



- Support UWB channels 5 & 9
- Centimeter-level positioning accuracy
- Low power consumption

50W Wireless Power Charging Module



- High efficiency charging
- Low power loss
- Over temperature/voltage/current protection
- Foreign object detection (FOD)

INPAQ Customization


Cellular


NFC


GPS


WPC


WiFi

 PSA 佳邦科技股份有限公司
ZINPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

INPAQ Empowering AMR Connectivity

Main Board


Mini Molding Power Inductor

PMIC


Mini Molding Power Inductor

Camera


Multilayer Varistor

Connected Module


ESD Suppressor


Metal Molding Power Inductor


Metal Molding Power Inductor


TVS Diode (Single, Array)


TVS Diode (Single)


TVS Diode (Single)


Power TVS Diode


Common Mode Choke


Chip Bead


ESD Suppressor


Multilayer Varistor


Chip RF Inductor


Multilayer Varistor


Power Transformer


Mini Molding Power Inductor


Chip Bead

 PSA 佳邦科技股份有限公司
ZINPAQ TECHNOLOGY CO., LTD.

Thank you

本資料均屬機密，僅供指定之收件人使用，未經寄件人許可不得揭露、複製或散佈本信件。

This message and any attachments are confidential and may be legally privileged. Any unauthorized review, use or distribution by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify the sender, completely delete this documents, and destroy all copies. Your cooperation will be highly appreciated.